



Heavy Ribbon Wedge-Wedge Bonder 5650HRI

Bond System

| | |
|---------------------------|---|
| Drahttypen | Aluminium-Bändchen bis 2000 x 300 µm Kupferdrähte 300 - 500 µm auf 4" Spule |
| Bondkopf | Wedge-Wedge für Bändchen od. Kupferdrähte Standard Tool von 2" Länge, (bis 90 mm) Motorisierte Drahtabspulung (optional) Programmierbares Voice-coil Bondkraftsystem Von 0 bis 1.800 cN (verstärkbar bis zu 4.000 cN) |
| Ultraschall System | F&S Generator 58 kHz (optional 40, 90, 120 kHz) |

Maschinen Basis

| | |
|------------------------------|---|
| Achsen | <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsbereich X/Y-Achse 100 x 100 mm Schrittauflösung 1 µm programmierbar Programmierbare Z-Achse mit 60mm Hub |
| Hardware | <ul style="list-style-type: none"> Dual-Core PC mit Windows OS Ethernet USB 2.0/3.0, LCD Farbdisplay 22" GigE-CMOS-Farbkamera Netzwerkfähig mit Programm-Archivierung |
| Software | <ul style="list-style-type: none"> Einzelbonds bis komplexe Programme Loopformen in Bibliotheken speicherbar Optionale Bilderkennung |
| Geschwindigkeit | <ul style="list-style-type: none"> 1 Draht / 3 Sekunden |
| Platziergenauigkeit | +/- 5 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S BONDTEC Standard-Substrat |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 3 µm @ 3 sigma, inkl. Tool/ohne Draht auf F&S BONDTEC Standard-Substrat |
| Loophöhengenaugigkeit | +/- 5 µm @ 3 sigma, bei Dünndraht 5630 mit 25 µm Aluminium Draht auf F&S BONDTEC Standard-Substrat |

Die 56xxi Serie:

Der semiautomatische Heavy Ribbon Bonder 5650HRI ist auf Basis der 56xxi-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die program-mierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

F&S BONDTEC bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bond-samples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell oder automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bond-samples (semi- u. vollautomatisch).

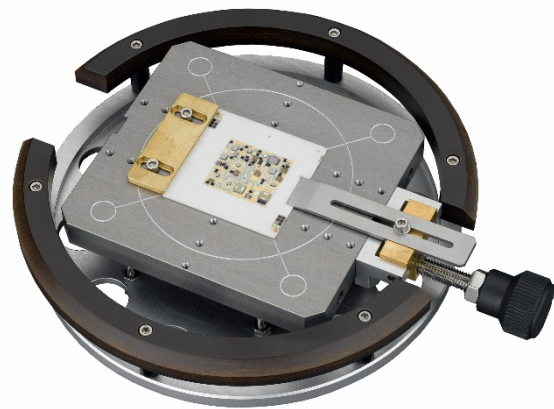
Durch einfachen Wechsel der Bondköpfe und der Software kann diese Maschine auch auf Dünndraht, Dick-draht Wedge-Wedge oder Ball-Wedge Wire Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/Sheartester einsetzbar.

Werkzeugloses Umrüsten ist in ca. 3 Minuten möglich.

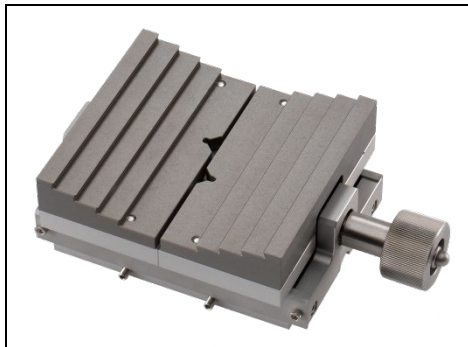
- Abmessung** B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 75 kg
- Anschlüsse** 100-240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max. 500 VA
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch
- Heizung** Steuerung in der Maschine integriert 0-250 °C

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Substrathalter 4x4"
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanischer Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

